



电子

优于大市（维持）

证券分析师

陈海进

资格编号：S0120521120001

邮箱：chenhj3@tebon.com.cn

研究助理

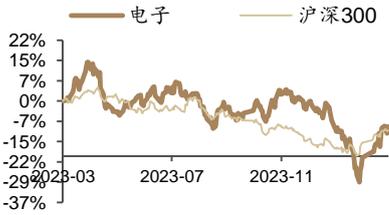
徐巡

邮箱：xuxun@tebon.com.cn

谢文嘉

邮箱：xiewj3@tebon.com.cn

市场表现



相关研究

- 《电子周观点：AI 有望再进化，持续关注算力芯片以及 AI 终端》，2024.3.17
- 《存储价格周度跟踪-0317：DRAM 颗粒价格分化，NAND 预计 Q2 持续上涨》，2024.3.17
- 《微软推动 AI PC 办公再进化，Vision Pro 推进多地发售》，2024.3.15
- 《GPT-4.5 Turbo 引发期待，重点关注 AI 盛会-算力系列跟踪》，2024.3.14
- 《电子月报（台股）2024-2：AI、存储、手机链景气向好》，2024.3.12

华为鸿蒙利好频出，本周关注 GTC、SEMI 大会-半导体系列跟踪

投资要点：

● **上周费半指数有所回调，A 股半导体涨势趋稳。**我们以 23 年初为基期分析指数累计涨跌幅。**(1) 半导体全行业表现来看：**近几月费城半导体指数和台湾半导体指数均有持续向上的行情，直至上周略有回调，上周 (0311-0315) 费城半导体指数在 4700-5000 点之间变化，较基期依然保持 90-100% 的上涨，台湾半导体指数维持在 500 点左右，较基期增长近 70%。申万半导体指数在经历今年 1-2 月的触底后已有反弹回升，上周 (03/11-03/15) 基本稳定维持在 3500 点附近，较基期跌幅维持在 15% 左右。**(2) A 股半导体细分板块来看：**以 23 年初为基期，上周收盘 (0315) 封测较基期累计涨跌幅超 10%，设备基本持平，数字、模拟、材料累计涨跌幅均为负。趋势上看，各细分板块均维持触底回弹，其中模拟芯片设计板块回弹幅度较弱，景气度恢复仍有待观察。

● **SIA 数据：预计 24 年全球半导体销售额有望实现两位数增长。**根据半导体行业协会 (SIA) 数据，全球/中国半导体销售额自 23 年初以来稳步增长至今，24 年 1 月环比微降 2%/3%，同比增长 15%/27%。SIA 预计全球半导体市场将在今年剩余时间内继续增长，24 年的年销售额有望实现两位数增长。全球半导体市场在经历了一段时间的低速之后，正迎来强劲的反弹。分板块来看，根据台股营收数据，24 年 1 月设计板块表现最为突出，营收同比增长 61% (基数较低)，环比增长 3%；制造板块近期月度营收波动较大，1 月营收同比增长 8%，环比增长 19%；封测板块近期较为平稳，1 月营收同比增长 11%，环比下降 5%；半导体材料 1 月营收同比下降 7%，环比下降 24%。

● **华为手机及物联网领域利好频出，持续看好鸿蒙生态星辰大海。****(1) 华为手机链：**据 Canalsys 最新发布数据，23Q4 华为手机中国市场份额达 14%，同比增长 47%。手机 SoC 方面，依靠华为 Mate60 系列、Mate X5 以及 nova 12 系列的优秀表现，华为海思 23Q4 出货 680 万颗，同比暴增 5121%；营收达到 70 亿美元，同比暴涨 24471%。根据集微网，华为将 24 年智能手机出货量目标定为 1 亿部，这一数字比先前机构预测高出 40%。另，得益于传音手机的扩张，紫光展锐 23Q4 出货同比增长 24%，传音占紫光展锐智能手机 SoC 出货量的 48%。**(2) 鸿蒙生态链：**3 月 13 日 2024 HarmonyOS Connect 伙伴峰会上，鸿蒙智选品类基线 V4.0 正式发布。芯海科技再次荣膺卓越伙伴，目前已成功导入 225 个鸿蒙智联项目商机 (23 年 8 月为 211 个)。3 月 14 日，金山办公与华为举办鸿蒙星河版 WPS Office 核心功能版本交付仪式，华为预计鸿蒙星河版将于 24Q4 发布面向消费者的商用版本。3 月 14-16 日 AWE 大会上，海尔机器人、乐聚机器人联合展出国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人 Kuavo (夸父)。

● 半导体板块跟踪：

| 数字：CPU/GPU：上周海光信息、寒武纪涨跌幅变化不大，但开年至今涨势如虹，累计上涨 13.69%/27.04%；上周龙芯+2.88%，3.15 发布公告 3C6000 已于 23 年底交付流片，2K3000 计划 24H1 交付流片，公司有望持续受益于信创 PC 自主可控硬性标准落地 (3.11 中央国家机关政府采购中心发文) +AI 推理框架软件 ONNX Runtime 对龙架构的生态支持 (3.12 公司发布公众号)。**FPGA：**上周安路科技、复旦微电、紫光国微、成都华微均有小幅下跌，仍然有待行业景气度改善。**其他数字 IC：**上周国芯科技+5.12% (3.12 公司发布公众号，与同驭汽车达成战略合作)，炬芯科技+4.66% (3.11 公司在上证 e 互动平台表示，将于 2024 年推出高端 AI 音频芯片)，峰昭科技+3.99% (美东时间上周三 Figure 01 人形机

器人 demo 发布且表现亮眼，机器人板块充分受益)。

| **存储**：上周佰维存储+10.06%，普冉股份+9.38%，兆易创新+8.13%，聚辰股份+6.89%。3.13 韩媒报道，三星电子计划将 NAND 闪存价格提高 15%-20%，存储预计持续迎来涨价，同时 DDR5 渗透率有望稳步提升。建议持续关注存储模组以及 DDR5 产业链。

| **模拟**：上周美芯晟+10.96% (3.4 公司发布公众号，荣耀手表 4 Pro 内置美芯晟无线充电芯片 MT5706；3.14 公司 MT581X MPP 无线充电模组获得 Qi2.0 认证)，帝奥微+9.21%。国产模拟芯片设计公司聚焦消费电子领域居多，华为 P60 手机于 2023 年 3 月 23 日发布，P70 后续有望发布，建议持续跟踪 P70 最新动态。

| **射频**：**蜂窝**：开年以来射频芯片设计公司普遍跌幅较大，或受到 Q1 消费电子淡季影响，持续关注 Q2/Q3 环比业绩修复表现及 L-PAMiD 等新产品营收贡献情况。**WiFi**：上周康希通信+11.05%，持续关注 2024 年公司 WiFi7 营收贡献以及导入手机 ODM 进展。

| **功率**：上周新洁能+12.66%，斯达半导+8.89%。我们认为光储、新能源汽车需求有望环比改善，同时服务器也望拉动相关功率产品需求 (MOS 等)。

| **设备**：上周华峰测控+12.38%，京仪装备+7.61%，富创精密+4.04%，金海通+3.00%。半导体封测设备此前股价回调较多，建议关注触底回升机会。同时，随着 24 年半导体需求的回暖，龙头晶圆厂预计重启扩产，关注核心龙头设备机遇。

| **制造**：上周赛微电子+5.4%，而中芯国际、华虹公司上周股价小幅回调。我们认为随着半导体设计库存逐步去化，晶圆代工厂有望在 24H2 迎来稼动率的明显改善。

| **封测**：上周气派科技+6.09%，涨势较好；封测龙头股价有所下跌，长电科技-3.52%，甬矽电子-3.00%，本月通富微电累计涨幅+14.86%，上周有所回调，股价下跌 2.19%；第三方测试公司股价略微上扬，利扬芯片+2.21%，伟测科技+1.43%。封测环节关注先进封装布局以及稼动率的后续恢复。

● 会议预告：

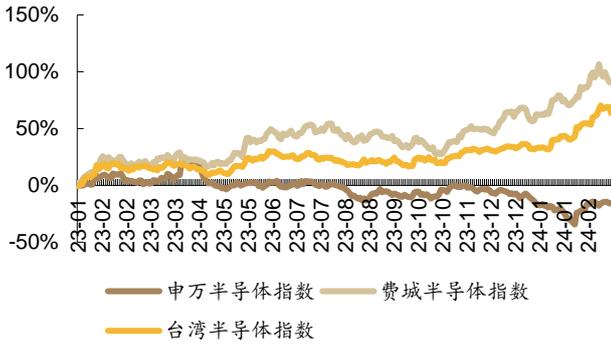
- 英伟达 GTC 大会：美国时间 2024 年 3 月 18-21 日
- SEMICON/FPD China：2024 年 3 月 20-22 日 | 上海新国际博览中心

● 建议关注：

- (1) **算力链**：寒武纪、海光信息、工业富联、沪电股份、通富微电等；
- (2) **存储**：江波龙、兆易创新、澜起科技、聚辰股份等；
- (3) **复苏链**：晶晨股份、纳芯微、韦尔股份、帝奥微、乐鑫科技、新洁能、斯达半导等；
- (4) **自主可控**：北方华创、中微公司、拓荆科技、龙芯中科等。

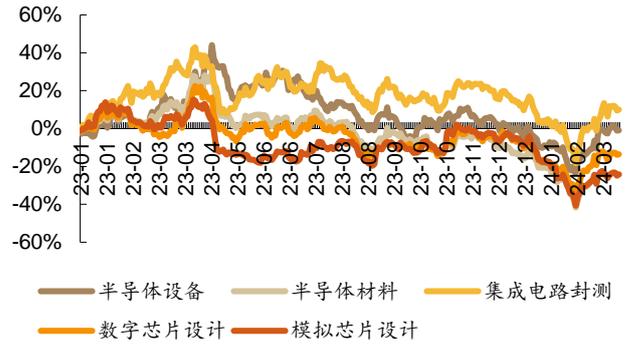
● 风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、全球贸易摩擦风险。

图 1：半导体指数涨跌幅复盘



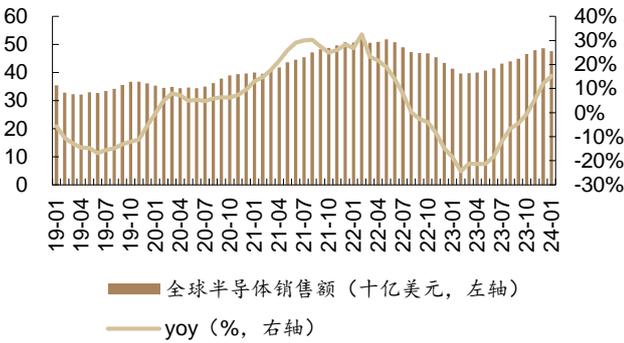
资料来源：iFind，德邦研究所
注：指数涨跌幅以 2023/1/3 日为基期

图 2：半导体指数涨跌幅复盘-分板块



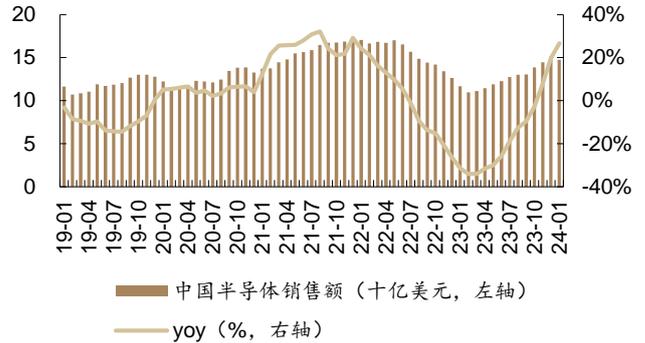
资料来源：iFind，德邦研究所
注：指数涨跌幅以 2023/1/3 日为基期；图中数据选取申万三级行业指数

图 3：SIA 全球半导体销售额及增速



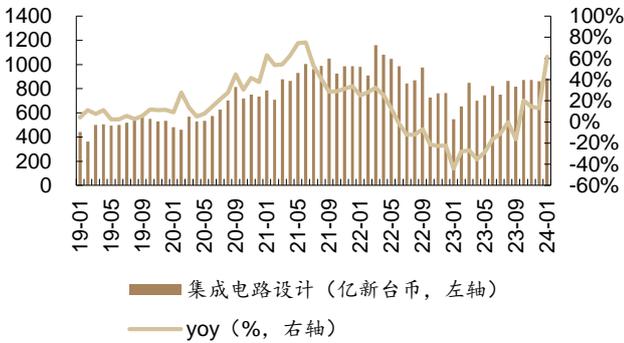
资料来源：iFind，德邦研究所

图 4：SIA 中国半导体销售额及增速



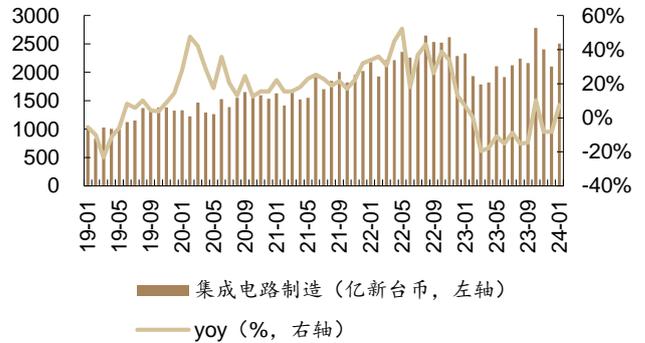
资料来源：iFind，德邦研究所

图 5：台股月度营收数据-集成电路设计



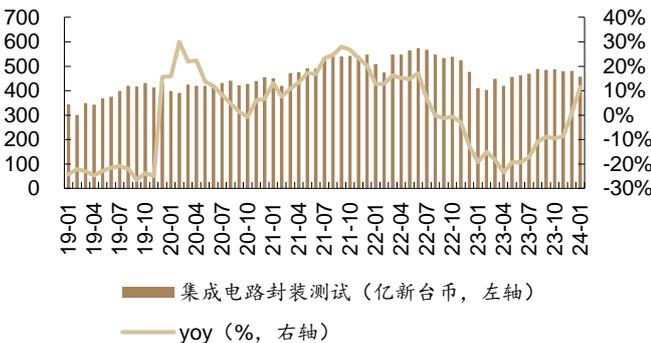
资料来源：Wind，德邦研究所

图 6：台股月度营收数据-集成电路制造



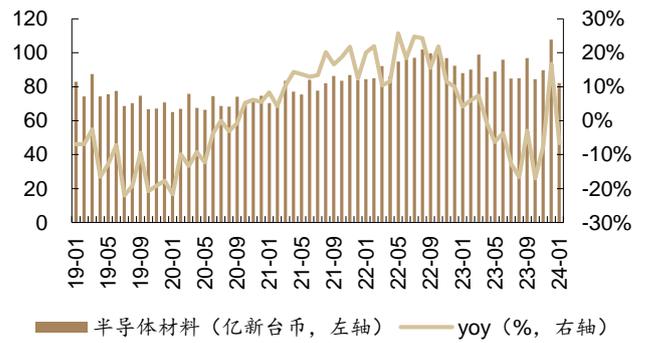
资料来源：Wind，德邦研究所

图 7：台股月度营收数据-集成电路封装测试



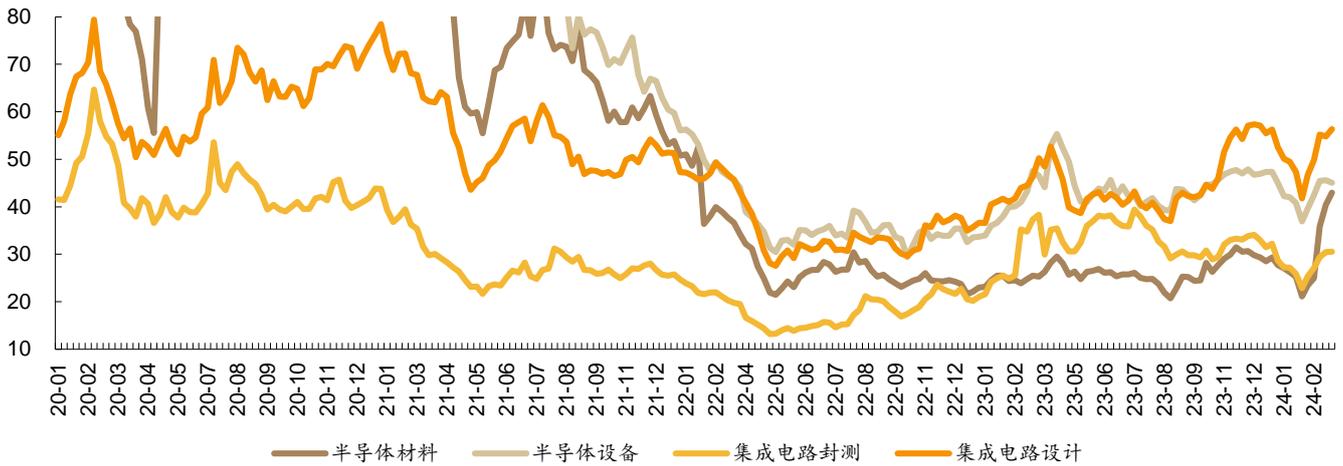
资料来源：Wind，德邦研究所

图 8：台股月度营收数据-半导体材料



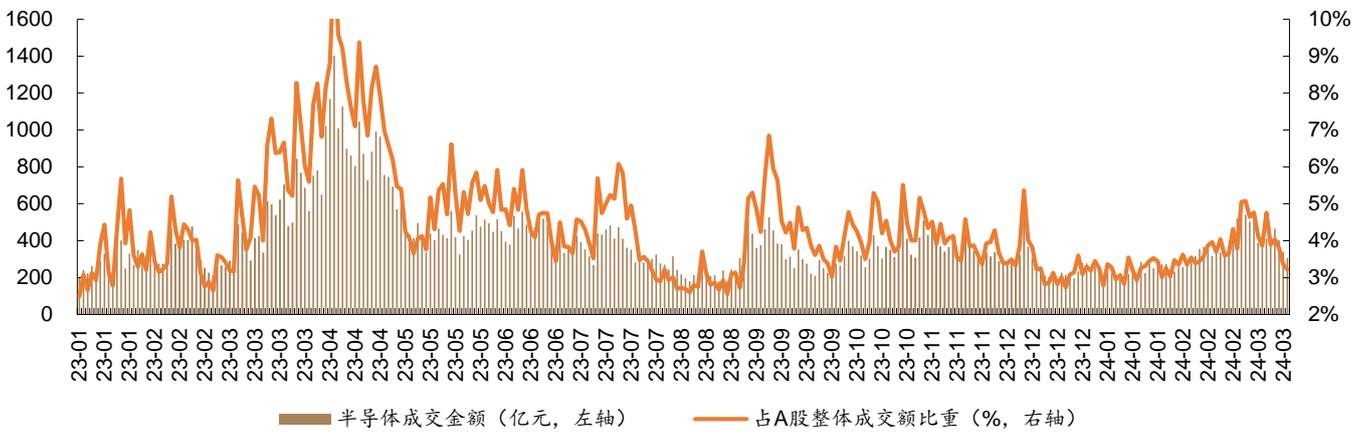
资料来源：Wind，德邦研究所

图 9：半导体细分板块估值水平



资料来源：iFind, 德邦研究所
注：图中数据为长江三级指数市盈率（PE），其中预测净利润选取次年（FY2）数据

图 10：半导体成交额及 A 股整体成交额占比情况



资料来源：iFind, 德邦研究所
注：半导体成交额选取图 9 指数加和，A 股整体成交额选取同花顺全 A（沪深京）指数

信息披露

分析师与研究助理简介

陈海进，德邦证券所长助理兼 TMT 组组长、电子首席分析师，8 年以上电子行业研究经验，曾任职于民生证券、方正证券、中欧基金等，南开大学国际经济研究所硕士。电子行业全领域覆盖。

徐巡，电子行业研究助理，上海交通大学经济学硕士，2 年以上电子行业研究经验，曾任职于凯盛研究院，覆盖 IC 设计、半导体设备与制造等领域。

谢文嘉，电子行业研究助理，香港大学硕士，覆盖模拟 IC 设计、数字 IC 设计等领域。

李雅文，电子行业研究助理，天津大学硕士，覆盖半导体模拟 IC、数字 IC、射频 IC 等领域。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准： 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅；	类别	评级	说明
2. 市场基准指数的比较标准： A 股市场以上证综指或深证成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	股票投资评级	买入	相对强于市场表现 20%以上；
		增持	相对强于市场表现 5%~20%；
		中性	相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
		减持	相对弱于市场表现 5%以下。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平 10%以下。

法律声明

本报告仅供德邦证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络德邦证券研究所并获得许可，并需注明出处为德邦证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，德邦证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。